

**2022年福田英才荟3.0“集成电路、人工智能研发奖励项目
第二批次拟支持名单**

序号	项目类别	企业名称	申请人	拟发放支持 金额 (万元)	代缴个人所 得税 (万元)	实际拟拨付 金额 (万元)
1	集成电路	深圳市汇顶科技股份有限公司	龙卫	10	2	8
2			陈飞飞	10	2	8
3			汪海翔	10	2	8
4			王程左	10	2	8
5			李博	10	2	8
6		深圳市九天睿芯科技有限公司	吴积方	10	2	8
7			张明	10	2	8
8		深圳智芯微电子科技有限公司	刘飞飞	10	2	8
9			何晓蓉	10	2	8
10		格物感知（深圳）科技有限公司	陈君雯	10	2	8
11			陆志东	10	2	8
12		深圳市稳先微电子有限公司	陈炼	10	2	8
13			刘鸿飞	10	2	8
14	人工智能	深圳佑驾创新科技有限公司	程追	10	2	8
15			俞吉	10	2	8
16		平安科技（深圳）有限公司	王健宗	10	2	8
17			黄章成	10	2	8
18			程宁	10	2	8
19			谭韬	10	2	8
20			瞿晓阳	10	2	8
21		和美（深圳）信息技术股份有限公司	万周斌	10	2	8
22			胡茂海	10	2	8
23		深圳市北科瑞声科技股份有限公司	王昕	10	2	8
24			黄石磊	10	2	8
25			程刚	10	2	8
26			蒋志燕	10	2	8
27			廖晨	10	2	8